

中信建投证券股份有限公司关于 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年度 持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“同享科技”或“公司”）的保荐机构，负责同享科技的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作概述

按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等规定，履行职责。包括：

1、督导公司规范运作，审阅公司信息披露文件及向中国证监会、北京证券交易所提交的其他文件；

2、协助和督促公司建立健全并有效执行公司治理、内部控制等各项制度、建立健全并有效执行内部控制制度，包括财务管理制度、会计核算制度，以及募集资金使用、关联交易等重大经营决策的程序和要求等，建立健全并有效执行信息披露制度；

3、督促公司按规定履行信息披露义务，审阅信息披露文件；持续关注公司是否存在应披露未披露的重大事项，按照相关法规要求，对上市公司关联交易等事项发表核查意见；

4、持续关注公司运作情况，通过日常沟通、定期或不定期回访、查阅资料，关注公司日常经营、证券交易和媒体报道等情况；

5、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；做好募集资金使用的核查及现场检查工作，出具对应的报告；

6、督促公司或其控股股东、实际控制人信守承诺，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺；

7、针对公司未及时将用于暂时补充流动资金的闲置部分募集资金按期归还至募集资金专项账户事项，保荐机构采取了现场检查措施，并在 2024 年 4 月 2 日，向北京证券交易所报送《中信建投证券股份有限公司关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项的专项现场核查报告》，具体内容详见“二、发现的问题及采取的措施”。

二、发现的问题及采取的措施

2023 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的情况下，将不超过 4,800.00 万元闲置募集资金用于暂时补充生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户。

公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金总额为 4,750.00 万元，截至 2024 年 2 月 25 日，公司已累计将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 3,280.00 万元提前归还至募集资金专项账户，但由于公司工作人员疏忽，本次部分闲置募集资金 1,470.00 万元暂时补充流动资金的使用期限超过 12 个月，公司已在第一时间进行了纠正，并于 2024 年 3 月 25 日将剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户。

针对该事项，保荐机构于 2024 年 3 月 27 日至 29 日对公司归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项进行了专项现场检查。对公司实际控制人、主要董事、监事、高级管理人员进行专题培训，发放募集资金管理和使用相关的学习材料，提示公司加强对募集资金存放及使用的管理，并向北交所报送了专项核查报告。

公司自查发现该事项后积极整改，及时归还用于暂时性补充流动资金的募集资金，并及时履行了信息披露义务。该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，

亦不影响募投项目正常建设，未对全体股东和公司的利益造成重大不利的影响。2024年5月31日，北京证券交易所上市公司管理部向同享科技及董事长兼总经理陆利斌、财务总监蒋茜采取口头警示的自律监管措施。

2024年度内，公司除上述募集资金使用过程中出现的问题外，公司在信息披露、公司内部制度建立与执行、股东会董事会运作、关联交易、对外担保、购买出售资产、对外投资等方面均按照北京证券交易所要求履行了相关的信息披露义务，未发现存在问题。2024年年度内，公司不存在控制权变化的情形，不存在发行人或者聘请的证券服务机构不配合保荐工作的情况。

三、公司及股东承诺履行情况

2024年年度内，公司及股东承诺履行情况如下表所示：

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	2024年度履行情况
实际控制人、控股股东	2024年3月7日	2025年4月1日	发行	摊薄即期回报与填补措施的承诺	详见《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》“第六节六、公司控股股东及公司董事、高级管理人员对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报措施的承诺”之（一）	已履行
董事、高级管理人员	2024年3月7日	2025年4月1日	发行	摊薄即期回报与填补措施的承诺	详见《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》“第六节六、公司控股股东及公司董	已履行

					事、高级管理人员对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报措施的承诺”之 (二)	
--	--	--	--	--	--	--

上述承诺具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号: 2024-040)。

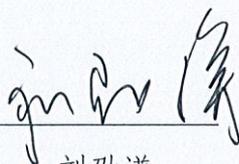
四、其他事项

2024 年年度内, 公司不存在面临的其他重大风险事项, 不存在控股股东、实际控制人、董事、高管股份质押冻结情况, 除募集资金核查事项外, 不存在交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

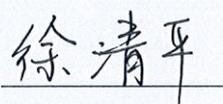
(以下无正文)

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



刘劭谦



徐清平

中信建投证券股份有限公司

2025年 11月 21日

